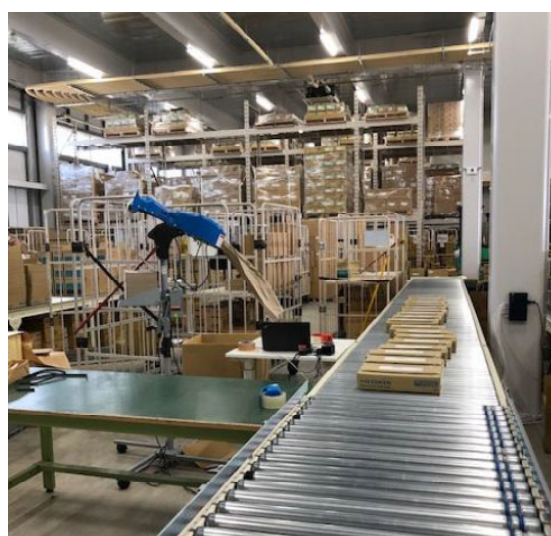


**1 製品あたりの梱包時間を 5～10 秒短縮 アイ・オー・データ機器に
P A L T E K が Ranpak 社の梱包用紙緩衝材を提供
作業効率改善・「脱プラスチック」の促進・労働環境改善に貢献**

株式会社 P A L T E K（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：矢吹尚秀、証券コード：7587、以下 P A L T E K）は、コンピュータの周辺機器の開発・製造・販売を行っている株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：濱田尚則、証券コード：6916、以下アイ・オー・データ）に、梱包用紙緩衝材の世界シェアトップクラスである Ranpak 社の紙緩衝材を提供し、アイ・オー・データの物流オペレーションを改善し、環境保全活動にも貢献しました。



FillPak® TTC を設置した梱包作業ライン

■ 紙緩衝材導入の経緯

アイ・オー・データは在庫管理や配送効率の向上を図るため、2019年3月に石川県能美市に「能美物流センター」を竣工しました。この「能美物流センター」は、今まで金沢市と近郊に点在していた10箇所の既存物流拠点を集約し、物流業務のさらなる効率化を目的とした施設で、パレットラックや自動仕分けコンベア、配送トラックへの積荷工程まで、スムーズな作業導線などが考慮されています。アイ・オー・データは、作業員が緩衝材（紙や新聞紙）を手作業で成型・梱包する工程についてもさらなる効率化を検討していたところ、緩衝材を自動的に排出する Ranpak 社の紙緩衝材システムで効率化が図られることがわかり、このシステムの導入を決定しました。

■ 導入した紙緩衝材システムとその効果

アイ・オー・データは、梱包箱のすき間埋めを行う Ranpak 社の FillPak[®] TTC を採用しました。

FillPak[®] TTC は、紙緩衝材を秒速 1.4m のスピードで排出することができ、紙は星形のような絞った状態で出力することで緩衝能力を高めます。紙緩衝材として使用されるクラフト紙は、FSC[®] 認証（※）を受けた森林から切り出される間伐材から作られた 100%バージンパルプを原料としており、環境にも配慮されています。

アイ・オー・データは物流センター内にある出荷ライン工程のコンベアに合計 17 台の FillPak[®] TTC を設置しました。これにより、1 製品あたりの梱包時間を 5～10 秒短縮することができ、出荷作業時間が大幅に削減できました。



■ アイ・オー・データおよび Ranpak 社からのコメント

株式会社アイ・オー・データ機器 事業戦略本部 生産購買部 物流課 チーフリーダー半田 慎一氏は次のように述べています。

「業務効率改善のため緩衝材が自動的に排出するシステムを探していた際に、Ranpak 社の販売代理店である P A L T E K が出展していた展示会のブースで、Ranpak の紙緩衝材システムの紹介を受けました。当初はプラスチック系のエアバッグタイプも検討していましたが、生産ラインの端などで緩衝材を作り溜めする必要があるため、作業員の安全面や作業時間という点では最適なソリューションではありませんでした。しかし、FillPak[®] TTC は手元で緩衝材を作れることに加え、機械にキャスターが付いているため、どこにでも動かすことができ、出荷量にあわせて設置場所を移動・調整できることが非常に魅力的でした。

また、FillPak[®] TTC の機械から必要な量（長さ）の紙が自動で出てくるように設定できるため紙の無駄使いがなくなり、作業員が手で紙を成型していた作業時間も大幅に削減することができました。これにより、1 日あたりの総出荷数量も増やすことができ、残業時間も少なくなったことで労務改善にもつながりました。また、紙を使うことは、プラスチックの使用削減にも貢献できており、Ranpak 社製品を導入して本当に良かったと思っています。」

Ranpak 株式会社 アジアパシフィック営業マネージャー 中村 昌史氏は次のように述べています。

「我々の製品がアイ・オー・データ機器様の物流オペレーションの改善活動に貢献でき、大変うれしく思います。ご提案時には今まで使われていた緩衝材の体積などを計算し、Ranpak の紙の必要量や梱包方法などを細かく検証させていただいた上で、的確な使用方法を提案させていただきました。この成果として、梱包作業時間の削減を実現できたと考えております。弊社の紙ベースの緩衝材がアイ・オー・データ機器様の顧客満足に貢献するものと確信しております。今後も同様の改善テーマをお持ちのお客様へ、最適な提案をさせていただけるよう引き続き精進していく所存です。」

■ アイ・オー・データ 採用事例インタビュー

今回の Ranpak 社の紙緩衝材の採用にあたり、導入時の状況などについてインタビュー記事をウェブサイトに掲載しています。

<https://www.paltek.co.jp/products/ranpak/case/iodata.html>

■ 専門用語説明

※ FSC[®]認証：

FSC[®]（Forest Stewardship Council[®]、森林管理協議会）は、木材を生産する世界の森林と、その森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関で、その認証は、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材に与えられます。このFSCのマークが入った製品を買うことで、消費者は世界の森林保全を間接的に応援できる仕組みです。

■ 株式会社アイ・オー・データ機器

1976年設立の精密機器メーカー。主にコンピュータの周辺機器を開発・製造・販売しており、この分野においては、市場から高い評価を受けている。高度化・多様化の一途をたどる情報社会の中、40年以上にわたり培ってきた技術を用いて、時代を見据えた商品展開により多様なニーズに応えることが使命。

アイ・オー・データ機器に関する詳細は、<https://www.iodata.jp> をご覧ください。

■ Ranpak 社について

Ranpak 社は世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。Ranpak BV は、欧州およびアジアに100以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリスなど）の成熟市場、東ヨーロッパ（ポーランド、スロバキア、トルコ）の発展途上市場、およびアジア太平洋（オーストラリア、日本、シンガポールなど）など、世界中に拠点があります。

Ranpak 社に関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

■ 株式会社 P A L T E K について

P A L T E K は、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。P A L T E K は、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

P A L T E K に関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■ この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社 P A L T E K 広報担当 柴崎 由記

メールアドレス：pr@paltek.co.jp

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話：045-477-2016 FAX：045-477-2012

2：本件に関するお問い合わせ

株式会社 P A L T E K Ranpak チーム担当者

メールアドレス：info_pal@paltek.co.jp

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話：045-477-2009 FAX：045-477-2146